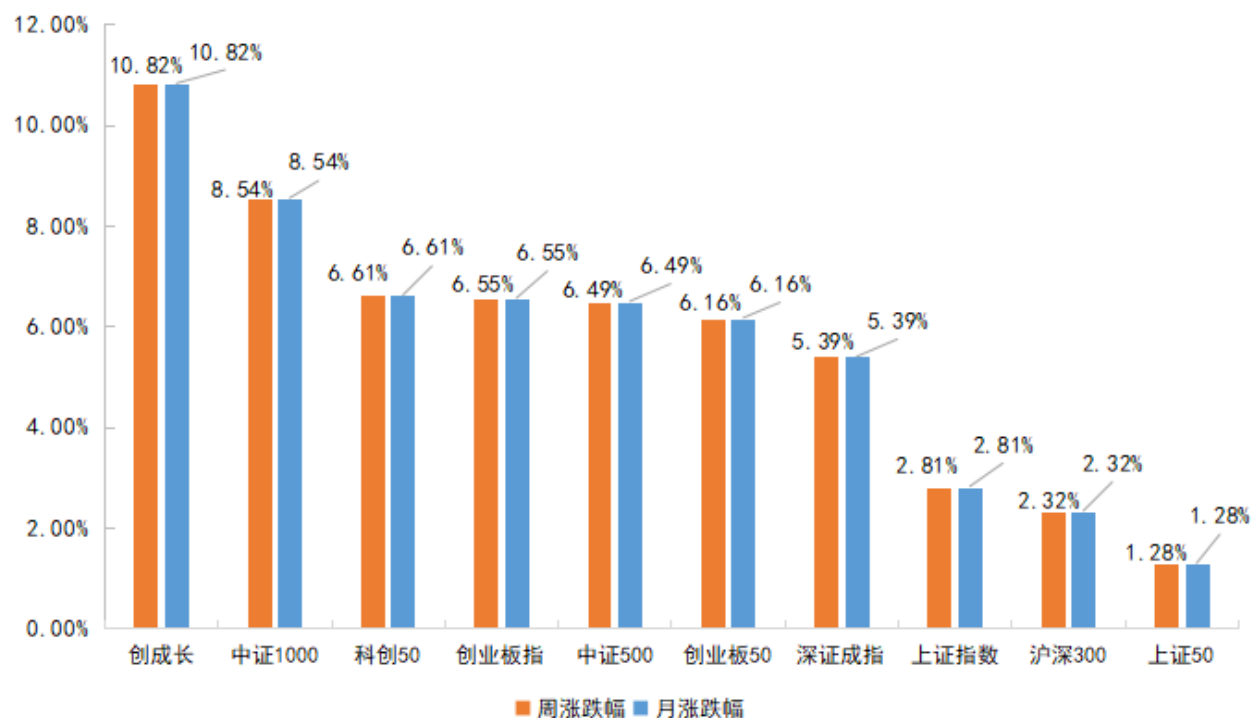


富荣权益：市场或进入风格发散与再平衡阶段

一、权益市场周度表现

上周（2026年8月3日至2026年8月7日，下同）权益市场反弹。各指数表现如下：创成长(+10.82%)、中证1000(+8.54%)、科创50(+6.61%)、创业板指(+6.55%)、中证500(+6.49%)、创业板50(+6.16%)、深证成指(+5.39%)、上证指数(+2.81%)、沪深300(+2.32%)、上证50(+1.28%)。

图：主要股指周度/月度涨跌幅（单位：%）

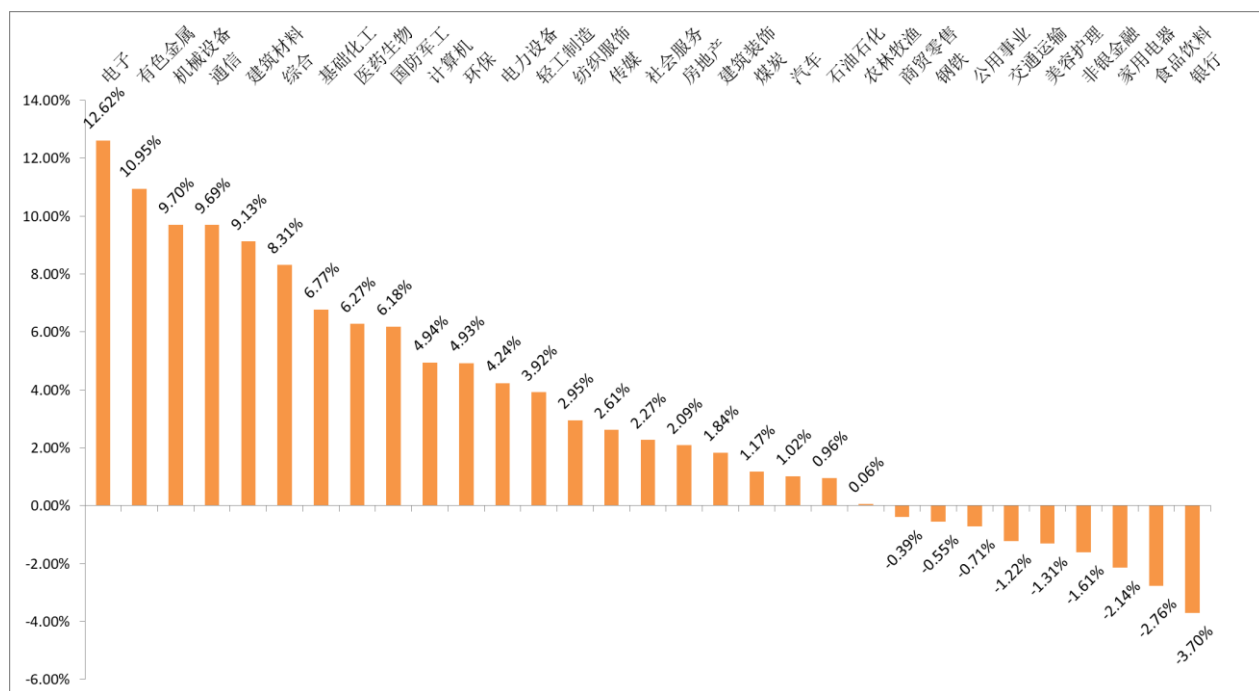


数据来源：wind，富荣基金；周涨跌幅统计区间：20260803-20260807；月涨跌幅统计区间：20260803-20260807

2026年8月3日-8月7日为8月首个交易周，因此周涨幅与月涨幅数值一致。

上周各行业分化明显，其中申万行业指数中，电子(+12.62%)、有色金属(+10.95%)、机械设备(+9.70%)等行业领涨，银行(-3.70%)、食品饮料(-2.76%)、家用电器(-2.14%)等行业逆市下跌。

图：申万一级行业周涨跌幅（单位：%）



数据来源: wind, 富荣基金; 统计区间: 20260803-20260807

二、电子行业点评与展望

上周沪深 300 指数上涨 2.32%，申万电子行业上涨 12.62%。电子中不同板块均有上涨，其中以 PCB、MLCC 为代表的元器件板块领涨 25.70%。

海外方面，上周纳斯达克指数上涨 5.19%、费城半导体指数上涨 9.25%，海外科技龙头财报与资本开支预期改善，推动 AI 硬件风险偏好修复。产业层面，市场关注点由单纯的 GPU 需求，进一步扩散至 PCB、覆铜板、MLCC 和液冷等机柜级配套环节。高盛将 2027 年全球 AI 服务器 PCB 和覆铜板市场规模预测上调，主要依据 AI 机柜放量、30 层以上高多层板及 M9 材料升级。与此同时，韩国龙头厂商自 8 月 1 日起上调 MLCC 价格，日本厂商亦计划跟进；AI 服务器高容 MLCC 产能占用增加，使部分通用产品库存降至 30 天以内。上周海外的产业变化是带动 PCB 和 MLCC 大幅上涨的重要原因之一。

国内方面，DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 已正式开启公测。据人工智能评测机构 Artificial Analysis 测算，即便 OpenAI 将 GPT-5.6 Luna 的价格下调 80%，DeepSeek-V4-Flash 正式版在其自有 API 体系下的单任务成本，仍较 GPT-5.6 Luna 低约 60%，成本优势突出。

未来建议继续围绕两条主线观察。第一，以 PCB 为代表的海外算力链仍是景气确定性较高的方向。Rubin 将推动主机板向高多层、HDI 和 mSAP 升级，同时带动高端覆铜板、电子布、铜箔及钻孔、曝光设备需求。第二，国内半导体设备兼具晶圆厂扩产与国产替代逻辑。SEMI 预计 2026 年全球半导体制造设备销售额有望实现同比增长，存储扩产、先进封装及海外设备限制均有利于国产设备导入。

三、本周展望

上周市场底部区间反弹，其中上证指数周涨跌+2.81%，深证成指周涨跌+5.39%，科创综指周涨跌+10.96%。行业结构上，电子、有色、机械设备等板块表现靠前，银行、食品饮料、家用电器等板块跌幅靠前。

上周市场触底反弹，其中前期跌幅较大的 AI 板块涨幅靠前，相对而言消费、金融等较为疲软。科技板块在快速下跌后迎来反弹，短期看基于资金面拥挤度以及前期市场高预期的背景下，向上突破或难以一蹴而就，需要新的产业叙事（如：模型迭代加速、新应用场景落地、AI 收入加速等）以重新凝聚共识。但基于中期维度，对于质地优异、明年业绩增长确定性较强的科技细分保持耐心与战略定力。

对于整体市场，未来 1~2 个月或进入风格发散与再平衡阶段，单一主线的极致化演绎大概率让位于多元机会的逐步显现。在非 AI 条线中，我们建议重点关注半年报业绩有望触底或出现拐点信号的细分方向，如部分中游制造、创新药等。建议继续沿两大主线展开：一是成长主线，聚焦 AI 算力、AI 应用及半导体等方向；二是非 AI 线：新能源、创新药。

风险提示：1、本材料中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料和合作客户的研究成果，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本材料所包含的信息或建议在本材料发出后不会发生任何变更，且本材料仅反映发布时的资料、观点和预测，可能在随后会作出调整。2、本材料中的资料、观点和预测等仅供参考，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。市场有风险，投资需谨慎。